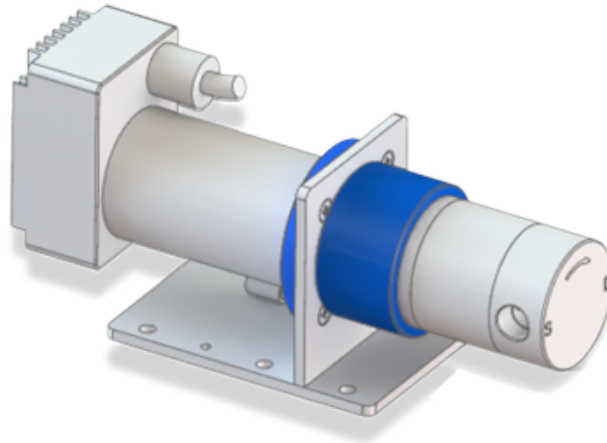


Produktinformation

Wärmedämmmodul · Ergänzungsmodule



Beschreibung

Mit dem Wärmedämmmodul lassen sich heiße Medien bis 150 °C fördern. Es beinhaltet eine thermisch dämmend ausgeführte Kupplungsbaugruppe aus Kunststoff (PEEK™) zwischen Pumpe und Antrieb. Die Wärmeübertragung von der Pumpe auf den temperaturempfindlichen Antrieb wird durch die Kunststoffabdeckung eingeschränkt. Eine Konvektionskühlung des Antriebs wird bei hohen Einschaltdauern und Medientemperaturen empfohlen.

Patente und Marken

Mikrozahnringpumpen (und Gehäuse) sind durch erteilte Patente geschützt: EP 1 354 135 B1; US 7,698,818 B2; DE 10 2011 001 041 B4; CN 103 348 141 B; US 10,012,220 B2; CN 103 732 921 B; US 9,404,492 B2; US 6,520,757 B1.

HNP M[®], mzi[®], MoDoS[®], µ-Clamp[®], µDispense[®], Centifluidic Technologies[®] sind eingetragene deutsche Marken der HNP Mikrosysteme GmbH.

Kontakt

HNP Mikrosysteme GmbH
Bleicherufer 25
19053 Schwerin

T +49 385 52190-300
F +49 385 52190-333
info@hnp-mikrosysteme.de

Stand 2019/07